

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）。
- 本次担保金额：惠州深科达智能装备有限公司（以下简称“惠州深科达”）拟为公司并购贷款授信额度提供担保，本次担保金额为 4,070 万元。截止本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 14,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 15.27%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。
- 本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内母公司提供担保，已履行惠州深科达内部审议程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。
- 本次担保无反担保。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，于 2024 年 3 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及合并范围内的子公司在授信期限内向银行等金融机构申请总额不超过人民币 7.10 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

根据公司发展战略需要，为进一步聚焦半导体设备业务，优化整合产业资源，提高管理效率，提升公司综合竞争力，公司拟以 9,600.00 万元人民币收购控股

子公司深圳市深科达半导体科技有限公司少数股东所持 40.00%的股权。为推进本次股权收购事项的顺利实施，公司拟向北京银行申请 4,070 万元的授信额度，贷款期限为七年，全资子公司惠州深科达为公司提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

(一) 深圳市深科达智能装备股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1001

法定代表人：黄奕宏

注册资本：9,445.6295 万元人民币

成立日期：2004 年 6 月 14 日

经营范围：一般经营项目是：智能信息终端嵌入式软件及系统整体解决方案、自动化制造工艺系统研发及系统集成、客户关系管理软件、数控编程软件、应用软件及工控软件的研发、销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外），许可经营项目是：机器视觉产品、智能贴合机器终端产品、智能邦定机器终端产品等智能装备和关键配套零部件的研发、生产和销售；电子半导体工业自动化设备、触摸屏及液晶显示器生产专业设备及其他自动化非标设备、设施、工装夹具的研发、生产和销售；直线机器人产品、相关零部件及其运动控制软件、驱动的研发、生产、销售。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	165,546.65	164,785.62
负债总额	70,618.98	63,451.65
净资产	94,927.66	101,333.97
项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	55,831.60	40,431.87
净利润	-11,568.03	-3,560.49

三、担保协议主要内容

(一) 担保人名称：惠州深科达智能装备有限公司

(二) 被担保人名称：深圳市深科达智能装备股份有限公司

(三) 担保方式：连带责任保证担保

(四) 担保金额：本金 4,070 万元人民币及其相应利息

(五) 担保期间：保证期间为被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 14,500 万元（全部为公司对控股子公司的担保），对外担保余额分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 8.76%及 15.27%，公司不存在违规担保、逾期担保情形。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日